

《5G》

5G 板块迎布局时机 四类股投资价值凸显

9月15日,中国兵器工业集团公司总经理、党组书记温刚,副总经理曾毅到中国移动通信集团公司调研,参观中国移动位于北京的5G试验外场,并与中国移动相关负责人进行了座谈。座谈会上,双方介绍了各自集团的相关情况,并就下一步可能合作的业务进行交流,表示将进一步加强联系,深化合作。

5G是互联网和新经济最重要的基础设施之一,受到了管理层高度重视。在8月24日,国务院再次发文力推信息消费升级,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,力争到2020年5G商用,推进物联网基础设施建设。另外,近日,中国信通院发布《5G经济社会影响白皮书》,到2030年,5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元,经济增加值2.9万亿元。同时在间接贡献方面,5G将带动总产出10.6万亿元,经济增加值3.6万亿元。

对此,国泰君安认为,目前,全球正加速5G建设,我国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着显著的先发优势,加速发展5G成为必然。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆(3倍~4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现,最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间,而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情,值得关注。

业绩方面,数据统计发现,在61家相关上市公司中,2017年中报归属母公司净利润实现同比增长的公司达到39家,占比65%。此外,截至昨日,已有23家5G类公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司有13



家,占比近六成。其中,日海通讯(444.55%)、北纬科技(155.75%)和国脉科技(130%)等3家公司预计2017年三季报归属母公司净利润同比翻番。

对于板块的后市机会,包括国泰君安、国信证券、海通证券等在内的多家券商发布研报表示看好5G产业链的投资机会。其中,海通证券则表示,国内和全球的5G网络建设有望加速,整体市场空间也将快速打开,5G将释放万亿元市场空间。

国泰君安表示,在政策驱动下,关注四类价值股后市机会。首先,主设备厂商,建议关注中兴通讯;2、需求将有确定性增长的光通信细分行业,关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技;3、借力产业升级,重塑市场格局的专网通信,关注海能达、亿联网络;4、密切关注工业4.0相关弹性受益标的:东土科技、佳讯飞鸿等。

■ 东方财富

《半导体》

应用需求爆发 芯片行业迎成长拐点

券商机构人士表示,全球半导体超级周期逻辑还在不断深化,“硅片供需剪刀差”愈演愈烈,半导体周期持续性、力度超过市场及产业周期核心原因也在这里,而具体演化路径,半年来已经得到深度验证。从美股来看,半导体及半导体设备板块在上周领涨所有细分板块,涨幅高达5.38%。“全球超级周期+国内科技红利拐点”将迎来的是未来5年的产业型机会,芯片行业正进入成长性拐点。

■ 叶涛

成长确定性强

近期,华为在柏林消费电子展(IFA)上发布全球首款移动端AI芯片——处理器麒麟970。

麒麟970是全球首款搭载神经网络处理单元NPU的移动端SOC芯片,集成了8核CPU、12核GPU、麒麟NPU、图像DSP、双ISP、4.5G LTE Modem等,在性能上远超iPhone 7Plus、三星S8,其CPU采用了目前ARM能效比最高的Cortex-A73方案,性能卓越,能效出众。

民生证券分析师郑平认为,麒麟970是国产处理器芯片的重大突破,将引领人工智能芯片从云端加速进入移动端。苹果、高通等科技企业正布局移动端AI生态,在今年的WWDC大会上,高通发布机器学习框架OpenM,苹果也正在研发Neural Engine的AI芯片。“凭借苹果在消费电子领域的影响力,以及高通在移动终端芯片领域的主导地位,移动AI芯片生态将在苹果、高通等企业引领下加速发展。”

目前来看,国内半导体产业投资建设稳步推进,台积电南京和英特尔大连的产能建设推进逐步进入后期,量产计划也随着逐步开始。新建项目方面,博世预计将在南京投资建设智能化助力器基地,徐州则计划建设传感器基地。此外,英伟达的靓丽财报以及日本经济产业省要出资采购设备和软件协助人工智能的研发,也反映了芯片行业受关注度的提升。

随着四季度临近,全球三大DRAM厂陆续召开针对明年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体研究中心调查,2018年DRAM厂的资本支出计划皆倾向保守。预计2018年DRAM产业供给增长率将维持在近年低点,低于需求增速,供给吃紧的态势将

延续。价格方面,过去一年DRAM已经实现翻倍。

华金证券认为,集成电路月度数据持续改善,在逐步进入产业旺季的过程中,存储器价格再次上升进一步明确了行业的景气状态。本月许多厂商纷纷在半年报方面给出了对于未来的预期,下游应用市场尽管智能手机等通讯设备依然是主流,但汽车电子和人工智能方面的需求增长速度较快,成为行业成长的驱动因素。

沿产业链布局

上游的情况更加印证了产业的景气状况。晶圆价格上半年整体涨幅较大,进入三季度后再次出现协议价格的上升,包括三星在内的行业龙头企业通过增加长期协议价格来获得较好的供应保障,而SUMCO则预计增加约4亿美元的资本开支来扩大产能,以应对需求的上升。

从A股走势看,半导体行业在半年报披露后的业绩情况较为理想,同比环比均处于上升态势,同时华为麒麟970芯片的问世也引发了资本市场对于行业的热切关注,过去两周相关指数持续上扬。华金证券蔡景彦认为,行业状况的持续乐观会在三季度进一步兑现到公司业绩层面,资本市场的投资者偏好逐步转变后,行业具备中短期内良好的投资机会。

其认为,从资本市场偏好看,集成电路作为轻资产的智慧密集型板块最新受到市场关注,也开始了上涨的趋势,近期半导体行业的次新股集中在半导体用的精细化学品、大宗化学品以及设备建设供应商等,预计也会在接下来受到市场关注。最后,集成电路封测产业则有望受到景气扩张利好带来产能利用率和盈利能力的扩大,成为基本面改善的标的选择。

立足于投资布局,中泰证券分析师认为,人工智能的核心在于云智能和端智能,产业机会在于数据分析处理、数据存储、数据传输三个关键环节。云经过多年发展已经广泛应用了,而基于端的提升是全球巨头必争的战略高地。移动互联网时代,手机已经成为数字化信息社会中人的代理,需要往更强大的感知系统、认知系统、安全系统和动力系统发展。除了云端芯片提升之外,基于手机智能终端、传感器、IOT、存储器等芯片提升是大势所趋。

《人工智能》

人工智能时代: AI赋能 世界重塑

密集投入,巨头引领,全球AI加速赋能:当前,全球每年有100+亿美金,累计1000+亿美金(Pitchbook数据统计),持续投入到全球AI的发展。巨头(谷歌/亚马逊/苹果等)引领,AI并购潮起,数据和人才成为并购争夺的重点。在资本和巨头的悉心呵护下,明星初创独角兽的不断涌现,AI加速赋能,面向医疗、金融、安防、教育、交通、物流等各类行业的企业级(B端)和消费级(C端)AI应用层出不穷。存量市场的革新,增量市场的创造,AI赋能加速,整体发展有超预期。

三大核心要素交互驱动:算法、数据、算力:(1)优质算法的不断迭代,以及算法隐含层数的增加(即深度神经网络DNN出现),使得AI仰仗的模型性能大幅优化;(2)互联网的发展,特别是移动互联网的快速繁荣,使得目前数据产生量已经远远超过用于训练AI模型的数据量。在目前仍以监督学习为主流的背景下,“数据标注成本高、算法隐含层数增加要求更多标注数据来训练模型”,这两个原因使得“可用”数据仍不足;(3)算力不断提升,GPU+CPU是目前机器学习首选的芯片组合。计算效率更高的FPGA、

ASCI等新型芯片兴起,不断挑战着GPU在机器学习领域中的地位。GPU、FPGA、ASCI各具优缺点,三种芯片的计算效率依次提高、灵活性依次降低、开发难度依次增加。

政策加码,AI上升到国家战略层面,存在弯道超车可能:有别于传统IT技术发展的滞后性,AI这一全新领域,国内的人才储备、政策、资本,是紧跟全球领先地位的发展,这也给弯道超车提供了可能。美国和日本分别于2016年发布《美国国家人工智能研究与发展战略规划》、《人工智能研发目标和产业化路线图》。而国内也于2017年7月重磅出台《新一代人工智能发展规划》,将AI发展上升到国家战略层面,分三阶段实施人工智能战略(理论和技术体系建设、完善及配套法律体系建设、AI应用发展),力争在2030年成为人工智能领域的世界领导者,核心产业规模超1万亿,带动相关产业规模超10万亿元。

AI赋能行业,应用不断深化,同时AIaaS的发展,显著降低AI创新门槛:我们以语音识别、智能投顾、智能安防为例,系统地阐述了AI赋能行业带来的显著变化,并看好企业级市场(B端)市场深度发力。同时,消费级AI有望在巨头的引领下产生质的变化。AIaaS实际上是AI应用服务收费方式从“许可授权”向“按需付费”的转变,从而降低了客户“智能化”实施的门槛。国内外AIaaS均从2016年底才开始起步,亚马逊AWS、阿里云、百度云纷纷推出基于GPU/FPGA云化解决方案,面向中小企/创业者提供创新服务,加速AI创新应用渗透。

投资建议:我们通过深度AI产业链调研和上市公司调研,看好AI加速赋能带来的行业快速成长趋势。重点推荐:科大讯飞、中科曙光、同花顺、苏州科达、熙菱信息、思创医惠、四维图新、东方网力、拓尔思,建议关注富瀚微、中科创达、浪潮信息、浙大网新、佳都科技、汉王科技、工大高新等。

■ 和讯